

EV Group Hybrid Bonding and Nanoimprint Lithography Solutions to be Highlighted at SEMICON TAIWAN 2023 – September 6, 2023

DIGITIMES

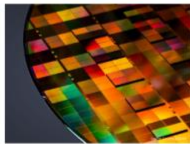
EVG在SEMICON Taiwan 2023展示混合鍵合與奈米微影壓印解決方案

林佩瑩 / 台北訊 2023-09-06 [分享](#) [分享](#)

EVG BONDSCALE 300 mm system - EVG

在SEMICON Taiwan 2023國際半導體展中，EV Group (EVG) 將重點介紹由該公司先進之晶圓到晶圓 (W2W) 與晶粒到晶圓 (D2W) 混合鍵合、檢測與奈米微影壓印 (NIL) 解決方案所帶來的3D集成和異質整合與擴增實境 (AR) 波導製造領域的全新發展。

EVG在2023年的展會論壇上將深入探討以下主題：首先，在「微機電暨感測器論壇」(9月5日，週二下午2點，台北南港展覽館一館5樓505ab室)，EVG將分享奈米微影壓印的多功能性與最新成就，並聚焦於超穎透鏡和擴增實境/虛擬實境技術的製造，以及這項技術能力的迅速崛起。其次，在「TechXPOT」(9月6日，週三下午2點，台北南港展覽館一館4樓L1100攤位)，EVG將介紹目前各種應用中對堆疊層計量要求，涵蓋從晶粒到晶圓、晶圓到晶圓，以及新型封裝技術中的晶粒位移的困擾等，例如具有適應性圖案化的無光罩曝光設備。



EVG - D2W晶粒到晶圓 - EVG

此外，在「半導體先進製程科技論壇」中(9月8日，週五下午2點，台北南港展覽館一館4樓402室)，EVG將對次世代記憶體和邏輯裝置相關的當前產業趨勢進行分享，重點聚焦3D集成如何實現新技術進步。最後，在「異質整合國際高峰論壇」上(9月8日，週五下午2:20，台北南港展覽館一館4樓401室)，EVG將討論晶圓到晶圓和晶粒到晶圓混合接合的當前產業趨勢和技術進展，包括關鍵的技術差異和整合場景。

EVG的晶圓接合、微影與檢測解決方案，使得先進封裝、微機電系統(MEMS)與化合物半導體等領域中技術創新的開發和大規模製造成為可能。EVG在異質整合和晶片級封裝方面的技術領導地位包括：混合鍵合技術應對3D裝置整合；晶圓接合對準技術應對未來3D-IC封裝需求的；紅外線雷射釋放技術消除先進封裝中的玻璃基板並實現薄層3D堆疊；無光罩曝光技術應用於扇出成型晶圓級封裝 (FOWLP)；以及奈米微影壓印技術支援晶片級光學元件 (WLO) 製造。

歡迎蒞臨SEMICON Taiwan 2023國際半導體展參觀EVG攤位L0316 (一館4樓)，以獲取更多相關資訊。

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000672504_PD6N6IL9OLM1ZP85A0D8EP